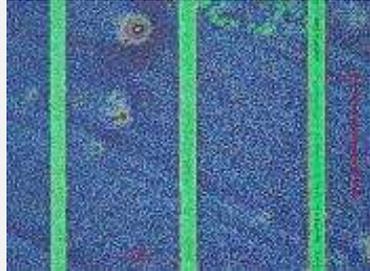


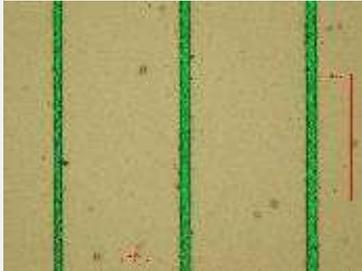
Laser micro processing

レーザー微細加工

「LaS Labs」でお客様の開発を強かにサポートいたします
 本社ラボ「LaS Labs」では、装置化に向けたプロセス開発や受託加工可否の判断、
 装置化のための再現条件出しなど、お客様のニーズに応じた技術支援を提供いたします

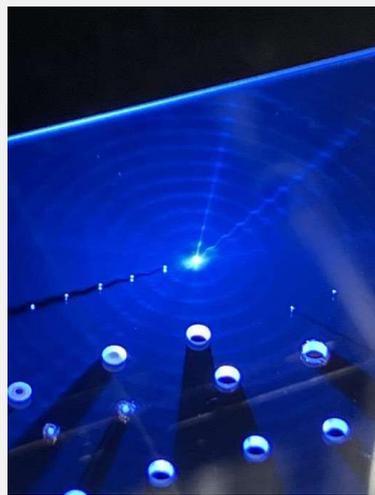


ペロブスカイト膜の除去



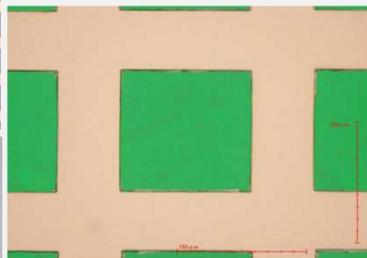
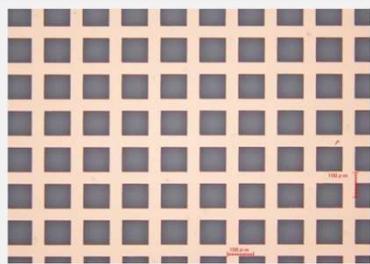
Au膜の除去

材料： 太陽電池
 加工： ペロブスカイト膜の除去
 Au膜の除去
 (レーザーエッチング)
 光源： フェムト秒レーザー (VIS)
 寸法： 溝幅 10~20μm
 溝深 約800nm
 速度： 200mm/s



Φ100umの穴あけ

材料： 無アルカリガラス
 (t=500μm)
 加工： 貫通穴加工
 光源： ピコ秒レーザー (UV)
 寸法： Φ100μm
 速度： 50秒/穴



1shot加工

材料： 銅箔付きPETフィルム材
 加工： 表面パターンニング
 光源： YAGレーザー (VIS)
 寸法： 加工像100μm□
 速度： 1ショットでの加工

